

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，并为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证；
- 被担保人：公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司和苏州德斯倍电子有限公司；
- 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元；
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
- 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司2024年度拟申请银行综合授信总额人民币8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子

公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证。为满足生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要，在上述担保额度内调剂使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）审批程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）昆山灵科传感技术有限公司基本情况

- 1、名称：昆山灵科传感技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：昆山开发区杨树路 553 号 2 号厂房一、二楼
- 4、法定代表人：李刚
- 5、注册资本：10600 万元整
- 6、成立日期：2018 年 05 月 25 日
- 7、经营范围：传感技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务；传感器、电子产品、电子设备、集成电路板、半导体器件研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；软件开发、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司关系：公司直接持有昆山灵科传感技术有限公司 100%的股权

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	12,735.10
负债总额	6,162.19
净资产	6,572.91
营业收入	4,634.57
净利润	-2,057.36

（二）苏州德斯倍电子有限公司基本情况

1、名称：苏州德斯倍电子有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号1-4楼

4、法定代表人：梅嘉欣

5、注册资本：9000万元整

6、成立日期：2019年04月10日

7、经营范围：生产：半导体分立器件、集成电路；半导体封装测试；从事各类商品和技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；光学仪器销售；软件销售；电子专用材料销售；幻灯及投影设备销售；终端测试设备销售；光通信设备销售；电容器及其配套设备销售；终端计量设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；机

械设备研发；半导体器件专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：公司直接持有苏州德斯倍电子有限公司 100%的股权

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	20,693.60
负债总额	12,525.23
净资产	8,168.37
营业收入	10,376.21
净利润	426.29

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司日常生产经营资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元，无逾期对外担保及涉及诉讼担保的情形。

六、监事会意见

经核查,我们认为本次公司及纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证事宜符合公司及子公司实际经营需求,并且担保的对象为公司全资子公司,目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,担保风险可控,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,监事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过,符合相关的法律法规,履行了必要的法律程序。本次向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及子公司融资及经营需求,符合公司的经营发展需要。

综上所述,保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 26 日